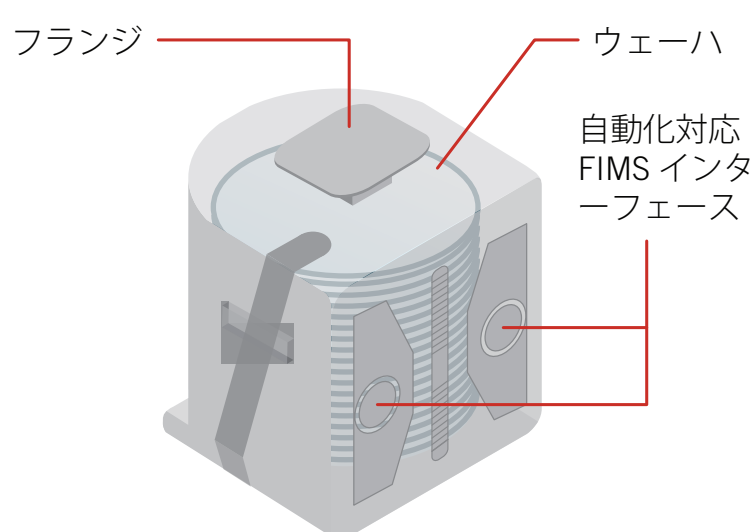


一貫したウェーハハンドリングのソリューション

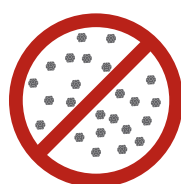
300 mm ウェーハには 15,000 もの重要な情報が含まれており、多くの場合、ウェーハは25 枚単位で搬送されます。これは、1 台の搬送容器に 75 万ドル相当の技術が搭載されている計算になります。それぞれの搬送容器は、半導体製造工程全体を通してウェーハの安全性、セキュリティ、純度を保護するように設計されています。インテグリスは、人の介入を最小限に抑えた一貫したウェーハハンドリングのソリューションを提供します。以下のような主な機能があります。



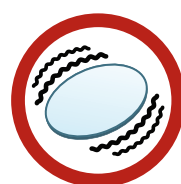
半導体工場に出荷される ベアウェーハ：FOSB



純度の維持



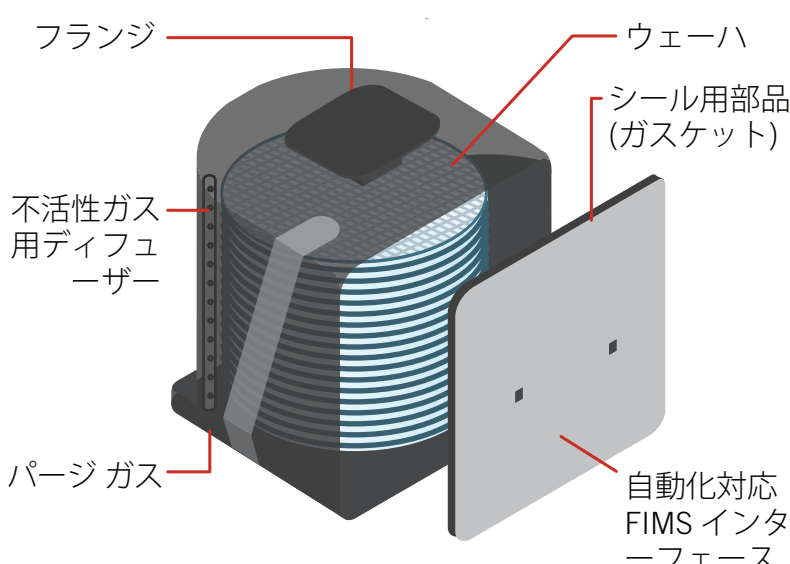
振動の影響を最小限に抑制



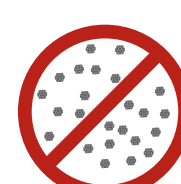
衝撃の影響を最小限に抑制



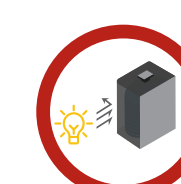
半導体工場全体: FOUF



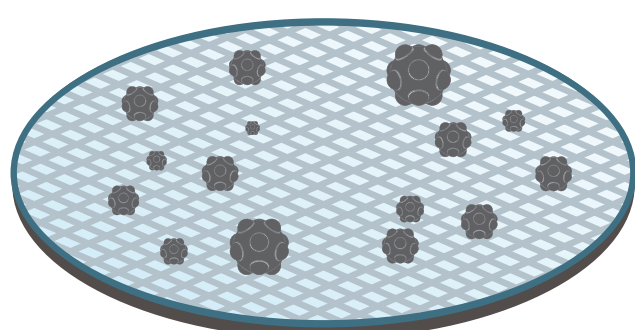
純度の維持



遮光



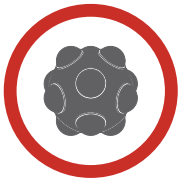
温度管理



ウェーハの歩留まりに 影響を与える汚染物質

ウェーハはその多くの時間が FOUF 内にあり、その環境を汚染物質から防ぐ必要があります。

粒子



揮発性有機化合物



酸素



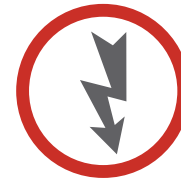
水分



空気中の分子状汚染物質



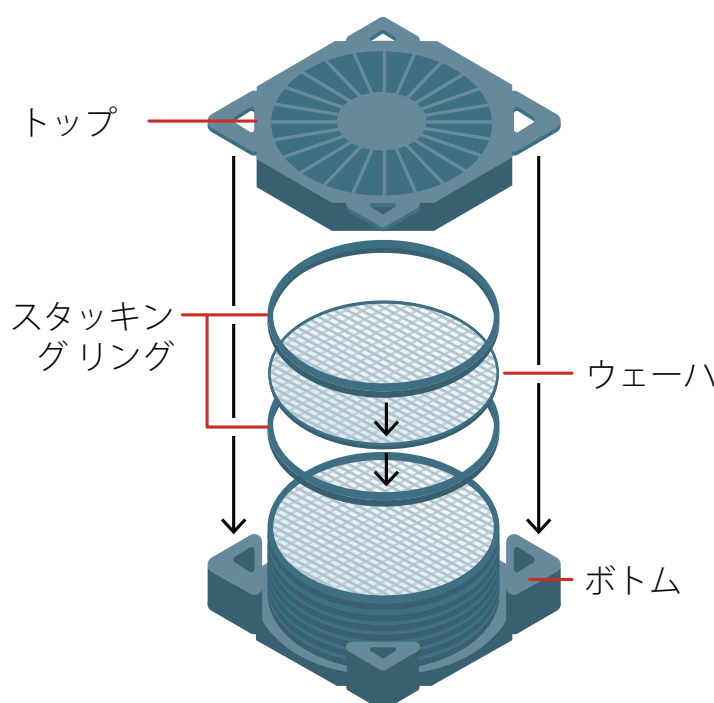
静電気



ウェーハの歩留まりが 1% 向上すると、1 億ドルを超える節約になります



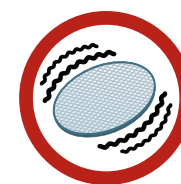
半導体工場からの輸送：ホリゾンタルウェーハシッパー



破損、傷、欠けを防止



振動の影響を最小限に抑制



衝撃の影響を最小限に抑制

